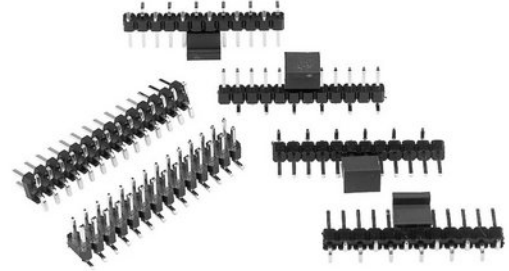


9532 / 9132

SMT-Stiftleisten RM 2,54mm, stehend - geprägte Kontakte SMT Pin Headers, 2.54mm Pitch, Vertical - Stamped & Formed Contacts

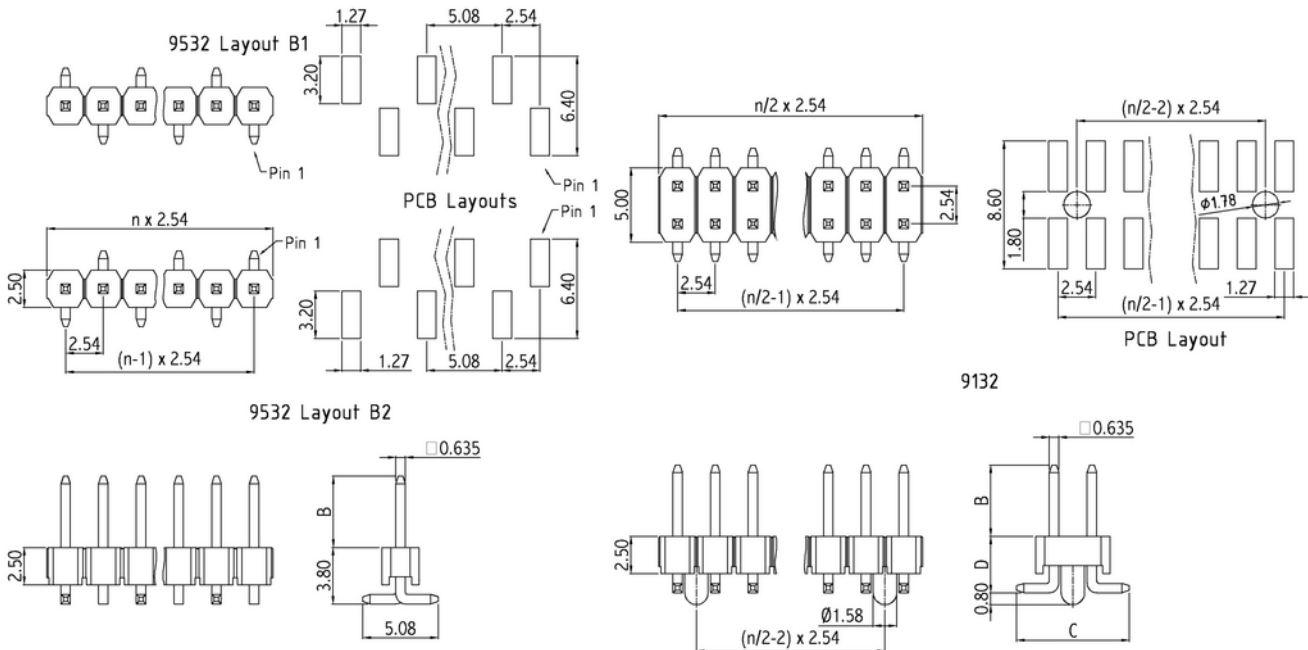
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung <i>Square pin 0.635mm, copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Lötbarkeit <i>Solderability</i>	IEC 60512-12A <i>IEC 60512-12A</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20mΩ <i>< 20mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ <i>> 1000MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1kV _{DC} <i>1kV_{DC}</i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250V _{AC} <i>250V_{AC}</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3A <i>3A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40°C ... +105°C <i>-40°C ... +105°C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten Serien:
Mate with Female Header Series:
3490 3491 etc.



Series*	Dimensions*	Contacts*	Plating*	Layout*	Loc. Peg*	Packaging*
9132	13	020	60	0	00	PPTR
Gestanzte/geprägte Kontakte <i>Stamped/formed contacts</i>	12 B=3,50mm 13 B=4,80mm 14 B=6,10mm 15 B=6,90mm	003-040 Einreihig <i>Single row</i> 004-038 Zweireihig, C=7,6 D=3,8mm <i>Double row,</i> C=7.6 D=3.8mm	00 Vergoldet <i>Gold plated</i> 50 Verzinkt <i>Tin plated</i> 60 Sel. Au/Sn <i>Duplex plating</i>	0 (Für Serie 9132) <i>(For series 9132)</i> 1 Layout B1 (9532) <i>Layout B1 (9532)</i> 2 Layout B2 (9532) <i>Layout B2 (9532)</i>	00 Ohne Pos.hilfe <i>W/o loc. peg</i> 10 Mit Pos.hilfe (9132) <i>With loc. peg (9132)</i>	ST PPST PPTR
9532 Einreihig <i>Single row</i>	16 B=9,90mm 17 B=5,84mm	040-080 Zweireihig, C=8,0 D=4,1mm <i>Double row,</i> C=8.0 D=4.1mm				
9132 Zweireihig <i>Double row</i>	18 B=8,13mm 99 Kundenspezifisch <i>Customer-specific</i>					

Weitere Stiftlängen und Veredelungen auf Anfrage.
More pin length and plating options on request.

Lieferformen / Packing Options:
ST In Stangen ohne Pick&Place-Pad / <i>In tubes w/o Pick&Place-Pad</i>
PPST In Stangen mit P&P-Pad / <i>In tubes with P&P-Pad</i>
PPTR Tape & Reel mit P&P-Pad / <i>Tape & Reel with P&P-Pad</i>

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0
FAX +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL sales@wpro.com
WEBSITE www.wpro.com

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

